

2017年3月期 決算説明会

2017年5月11日



本日説明のポイント

■2017年3月期業績

売上高 2,706億円（前期比 3.2%減）

経常利益 26億円（前期比 20.2%減）

■業績修正(営業利益+ 9 億円、経常利益+ 6 億円、純利益+ 7 億円)

■2018年3月期業績見通し

売上高 2,600億円（前期比 4.0%減）

経常利益 33億円（前期比 24.5%増）

■中期経営計画

デバイス事業

- 自動車・産業機器市場に注力
- 医療・IoT分野での事業強化

システム事業

- 情報通信機器を独立部門として事業拡大

2017年3月期 決算の概要

2017年3月期 連結決算サマリ（対前期比）

■売上高 2,706億円（前期比 88億円減、10月予想比 6億円 0.3% 増）

- デバイス事業 通信モジュール向け半導体、TV・PC向けLCDパネルの減少
- システム事業 電子部品組立検査装置の増加

■営業利益 28億円（前期比 3億円減、10月予想比 9億円 51.7% 増）

- 売上総利益 利益率の高い商品の構成比の増加
- 販管費 退職給付費用、子会社増加による人件費・販売活動費の増加

■経常利益 26億円（前期比 6億円減、10月予想比 6億円 32.6% 増）

- 営業外費用 為替差損429百万円

■当期純利益 16億円（前期比 1.6億円減、10月予想比 7億円 83.3%増）

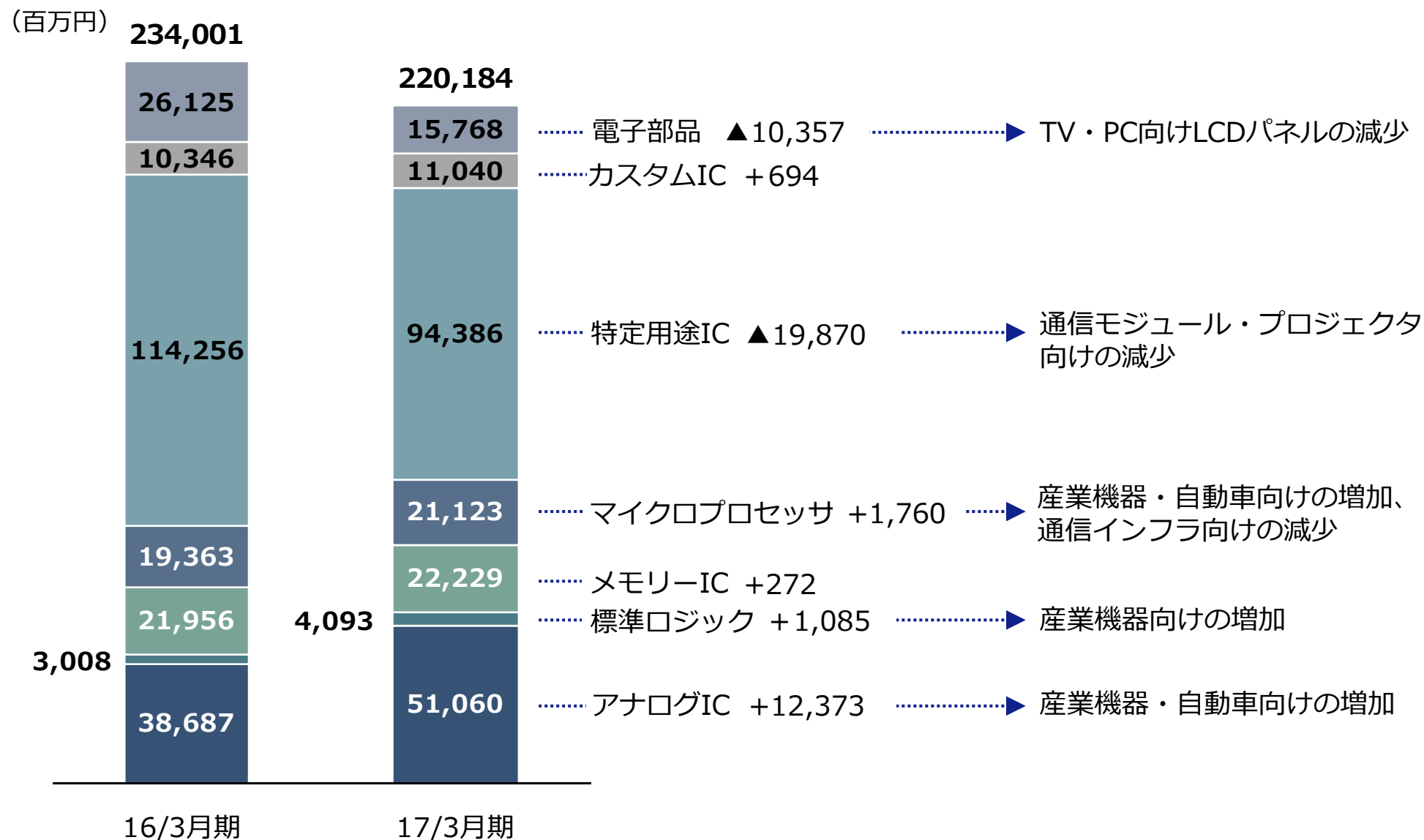
■業績修正要因

- 売上総利益率の改善、為替レートが円安に推移、販管費の節減

2017年3月期 業績サマリ

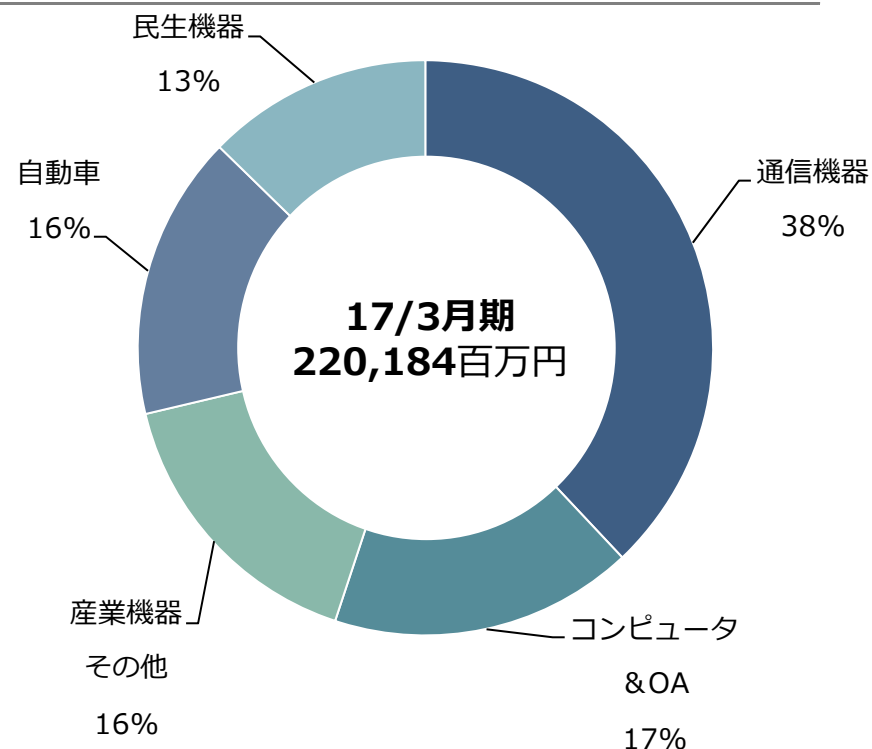
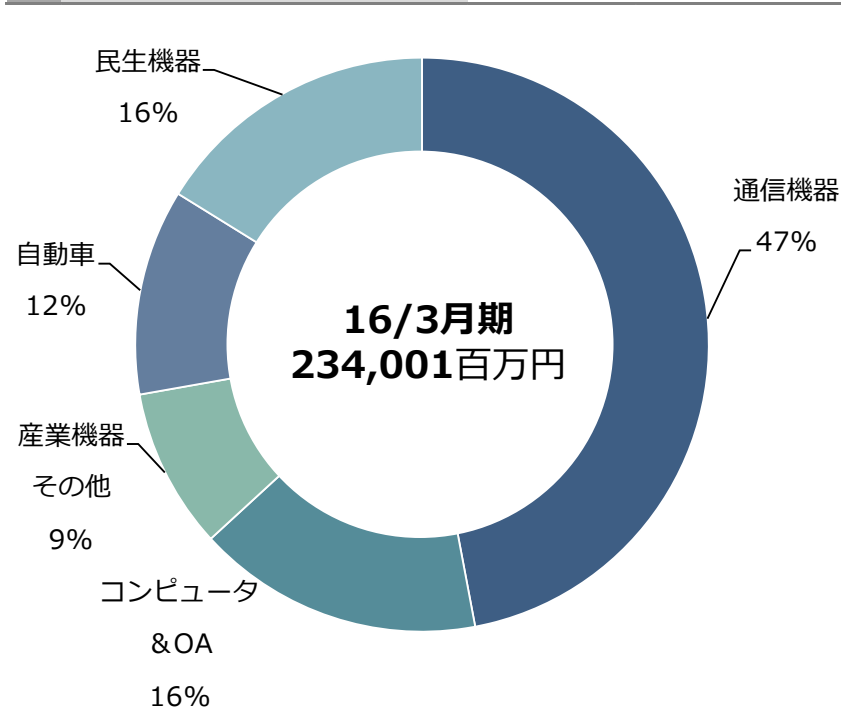
(百万円)	16/3月期		17/3月期		前年同期比		17/3月期 予想	
	実績	構成比	実績	構成比	金額	%	16/10月予想	構成比
売上高	279,571	100.0%	270,698	100.0%	△ 8,873	-3.2%	270,000	100.0%
デバイス事業	234,001	83.7%	220,184	81.3%	△ 13,817	-5.9%	219,000	81.1%
システム事業	45,570	16.3%	50,513	18.7%	4,943	10.8%	51,000	18.9%
売上総利益	18,319	6.6%	20,612	7.6%	2,293	12.5%	20,000	7.4%
販管費	15,106	5.4%	17,729	6.5%	2,623	17.4%	18,100	6.7%
人件費	9,264	3.3%	10,909	4.0%	1,645	17.8%	-	-
その他	5,842	2.1%	6,819	2.5%	977	16.7%	-	-
営業利益	3,212	1.1%	2,883	1.1%	△ 329	-10.2%	1,900	0.7%
営業外収益	734	0.3%	705	0.3%	△ 29	-4.0%	850	0.3%
営業外費用	624	0.2%	937	0.3%	313	50.2%	750	0.3%
経常利益	3,321	1.2%	2,651	1.0%	△ 670	-20.2%	2,000	0.7%
特別利益	870	0.3%	1	0.0%	△ 869	-	10	0.0%
特別損失	893	0.3%	65	0.0%	△ 828	-92.7%	60	0.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,810	0.6%	1,650	0.6%	△ 160	-8.8%	900	0.3%
期末従業員数（名）	1,266	-	1,397	-	131	10.3%	-	-

2017年3月期 デバイス事業品目別売上高

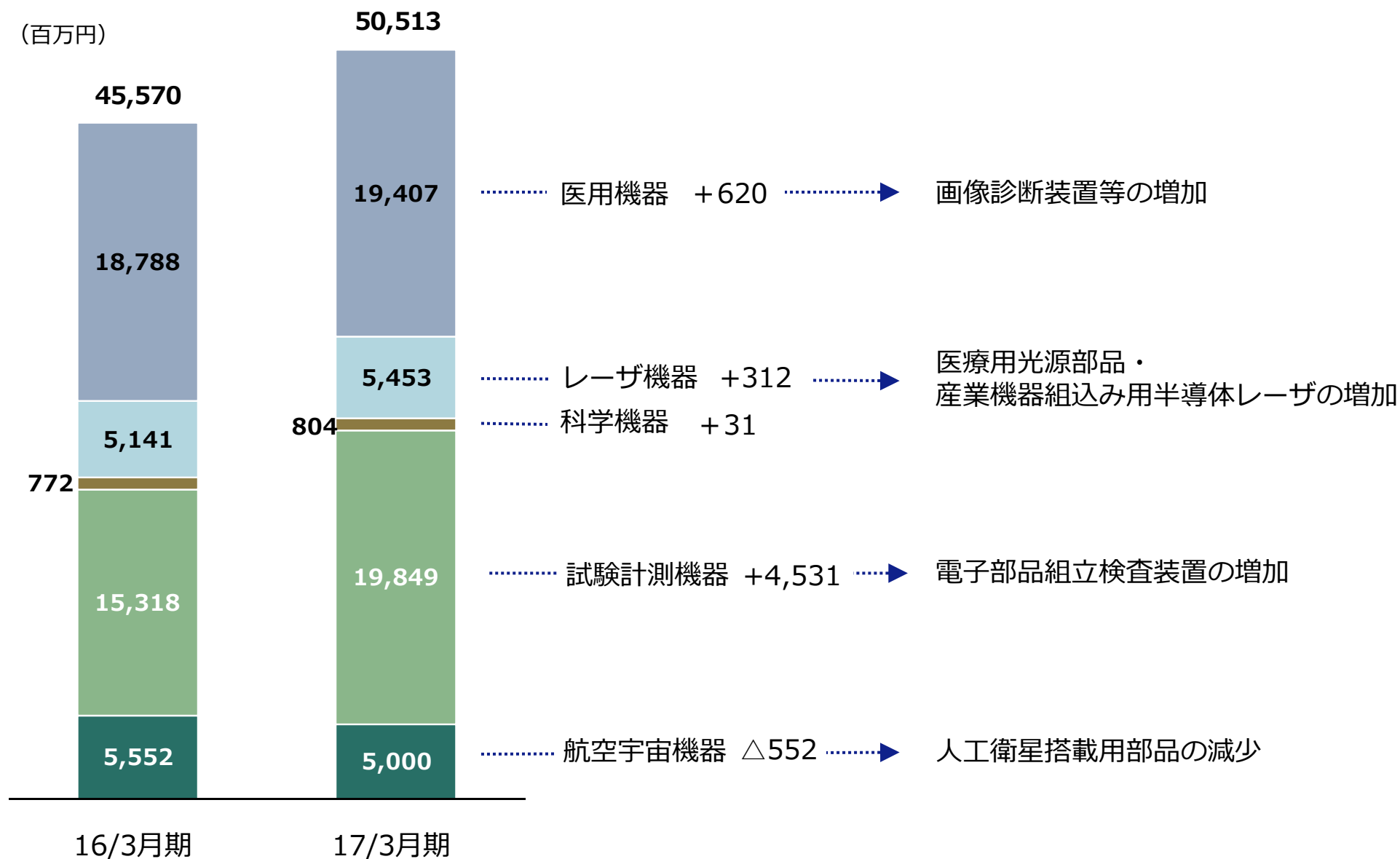


2017年3月期 デバイス事業 用途別市場動向

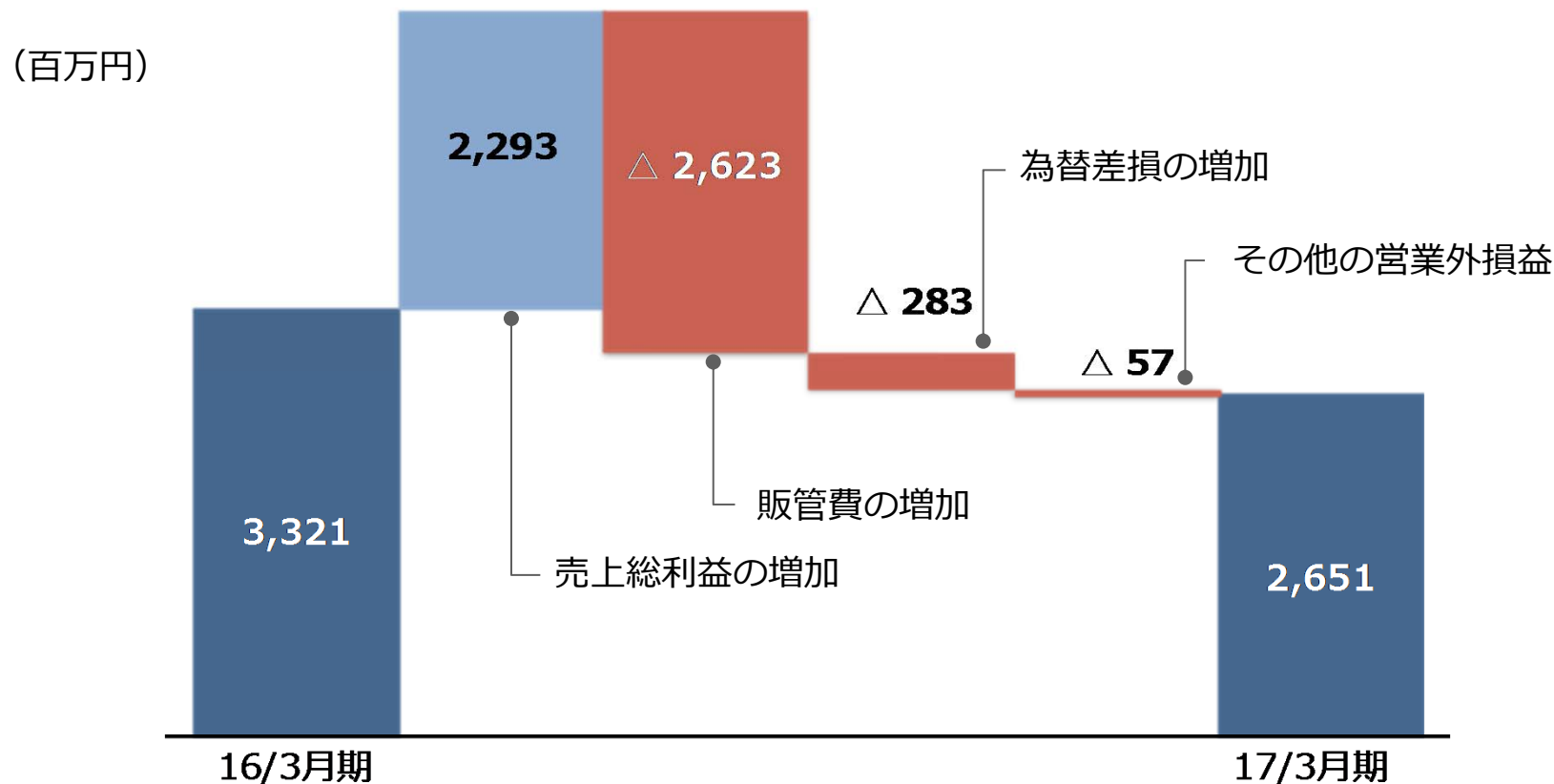
用 途	市 場 動 向
産業機器その他	FA機器向けが増加
自動車	ナビゲーション・車内通信・エンジンコントロール向けが増加
コンピュータ&OA	PC向けが増加、OA機器向けが減少
通信機器	通信モジュール向けが減少
民生機器	TV・ゲーム機向けが減少



2017年3月期 システム事業品目別売上高



2017年3月期 経常利益の増減要因



売上総利益	利益率の高い商品の構成比増による売上総利益の増加 16/3月期：183億円（6.6%） → 17/3月期：206億円（7.6%）
販管費	子会社増加や退職給付費用の増加 16/3月期：151億円 → 17/3月期：177億円
営業外損益	為替差損の増加 16/3月期：差損1.4億円 → 17/3月期：差損4.2億円

2017年3月期 貸借対照表の概要

(百万円)	16/3月期末 実績	17/3月期末 実績	前期末比 増減額	主な増減理由	
資産合計	106,513	125,984	19,471	受取手形及び売掛金	11,904
流動資産	96,211	113,711	17,500	商品及び製品	4,620
固定資産	10,302	12,273	1,971		
負債合計	60,175	78,434	18,259	支払手形及び買掛金	2,066
流動負債	49,481	67,272	17,791	短期借入金	15,345
固定負債	10,693	11,161	468		
純資産合計	46,338	47,550	1,212	株主資本	918
				その他の包括利益累計額	428
				非支配株主持分	△ 134

2017年3月期 キャッシュフロー計算書の概要

(百万円)	16/3月期 実績	17/3月期 実績	主な増減理由
			税引前当期純利益 2,587
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 1,204	△ 5,894	売上債権の増加 △ 6,972 棚卸資産の増加 △ 1,925 仕入債務の増加 1,450
投資活動による キャッシュ・フロー	493	△ 1,862	固定資産の取得による支出 △ 1,017 子会社株式取得 △ 286 仕入先株式取得 △ 234
フリー・キャッシュ・フロー	△ 711	△ 7,756	
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 6,724	6,282	短期借入金の純増 7,456
現金及び現金同等物の増減額	△ 7,810	△ 1,485	
現金及び現金同等物の期末残高	13,702	12,216	

2018年3月期 業績予想の概要

2018年3月期 業績予想サマリ

■売上高 2,600億円（前期比 106億円 4% 減）

- デバイス事業 通信モジュール向け半導体の減少、NXP代理店解消の影響
- システム事業 医療用光源部品の増加、電子部品組立検査装置の減少

■営業利益 35億円（前期比 6億円 21.4% 増）

- 売上総利益 売上総利益率の改善
- 販管費 退職給付費用等の減少

■経常利益 33億円（前期比 6億円 24.5% 増）

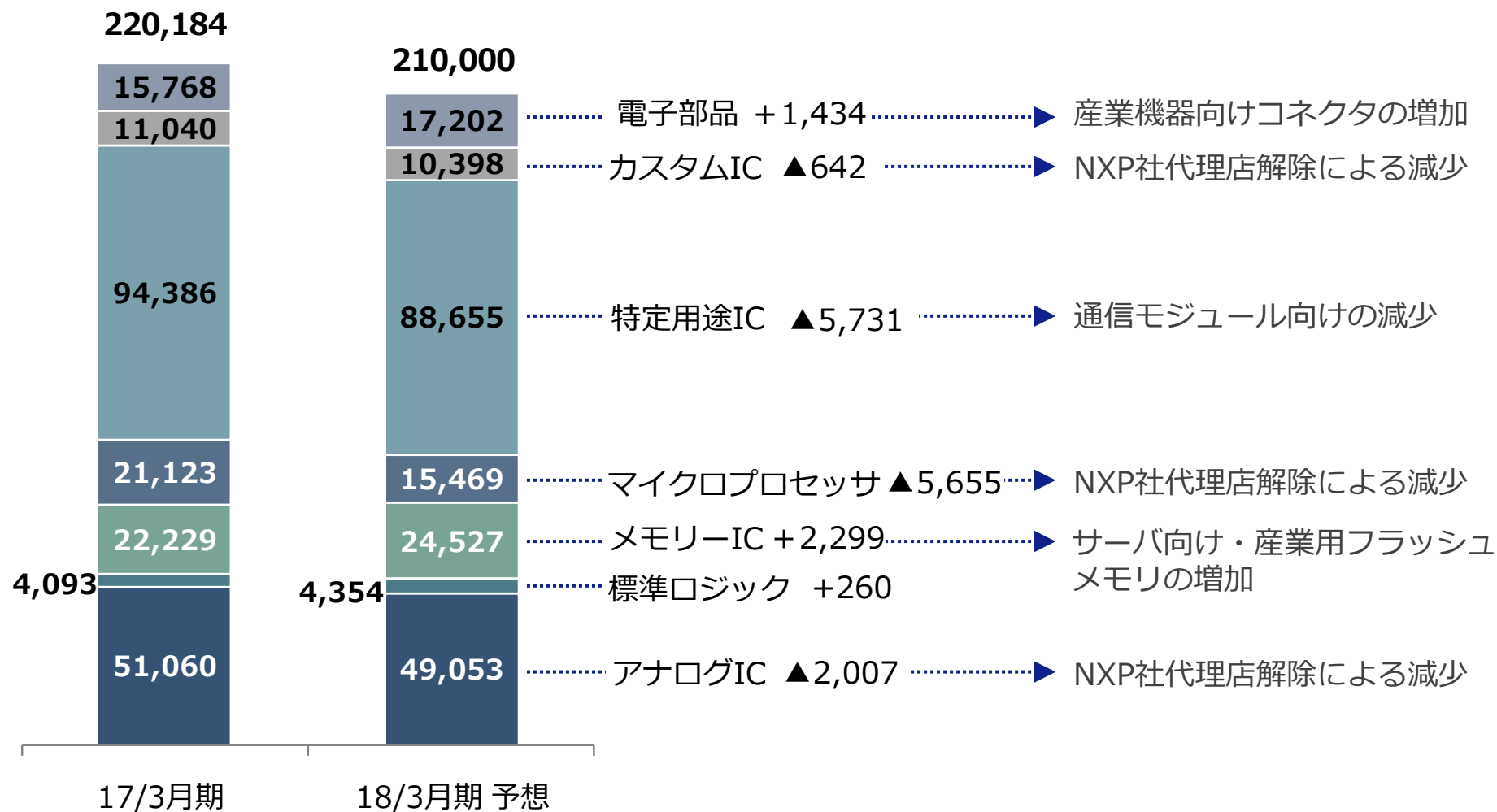
■当期純利益 18億円（前期比 2億円 12.1% 増）

2018年3月期 業績予想サマリ

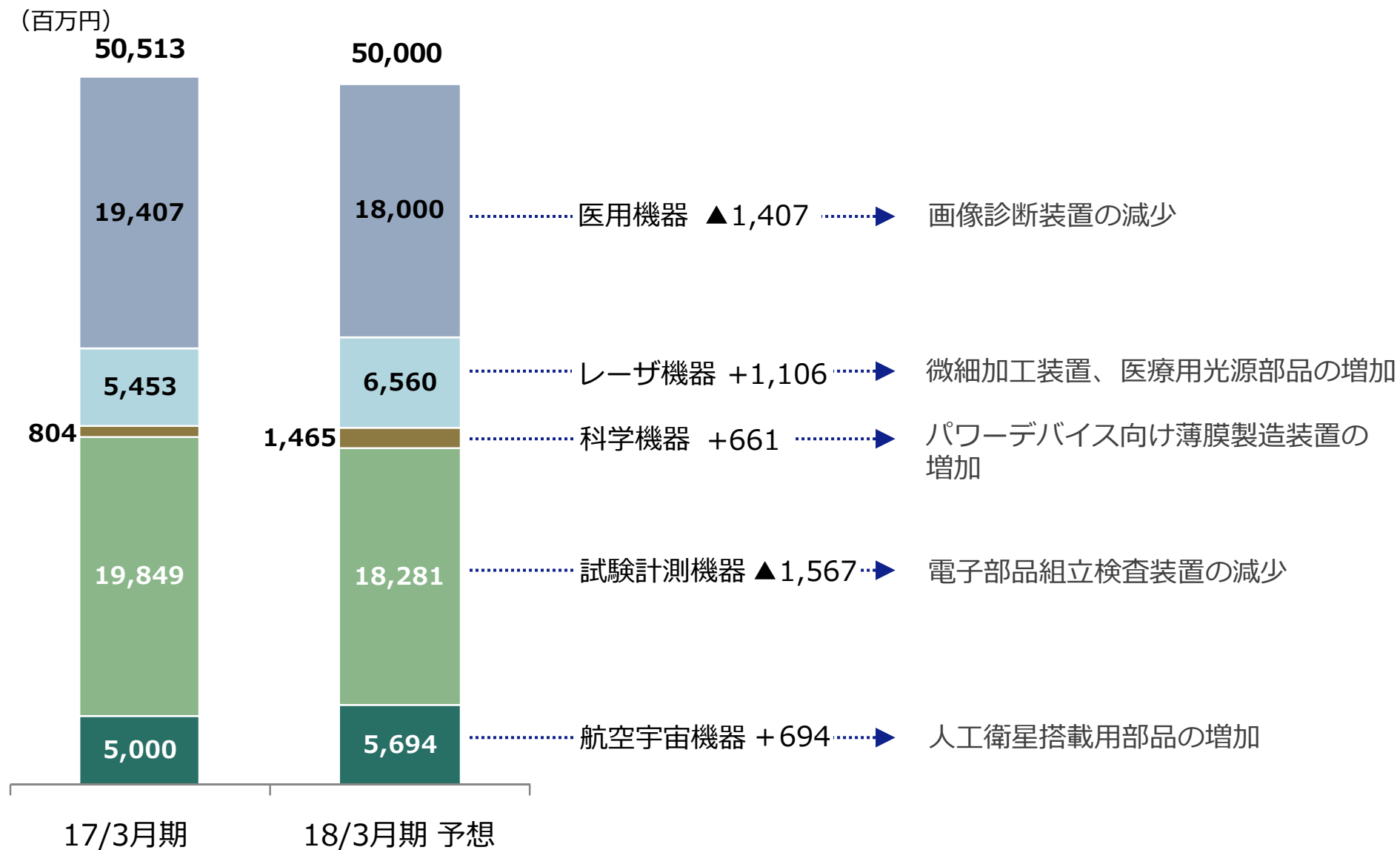
(百万円)	17/3月期		18/3月期		前期比	
	実績	構成比	予想	構成比	増減額	%
売上高	270,698	100.0%	260,000	100.0%	△ 10,698	-4.0%
デバイス事業	220,184	81.3%	210,000	80.8%	△ 10,184	-4.6%
システム事業	50,513	18.7%	50,000	19.2%	△ 513	-1.0%
売上総利益	20,612	7.6%	21,000	8.1%	388	1.9%
販管費	17,729	6.5%	17,500	6.7%	△ 229	-1.3%
営業利益	2,883	1.1%	3,500	1.3%	617	21.4%
営業外収益	705	0.3%	450	0.2%	△ 255	-36.2%
営業外費用	937	0.3%	650	0.3%	△ 287	-30.6%
経常利益	2,651	1.0%	3,300	1.3%	649	24.5%
特別利益	1	0.0%	0	0.0%	△ 1	-100.0%
特別損失	65	0.0%	50	0.0%	△ 15	-23.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,650	0.6%	1,850	0.7%	200	12.1%

2018年3月期 デバイス事業品目別売上高予想

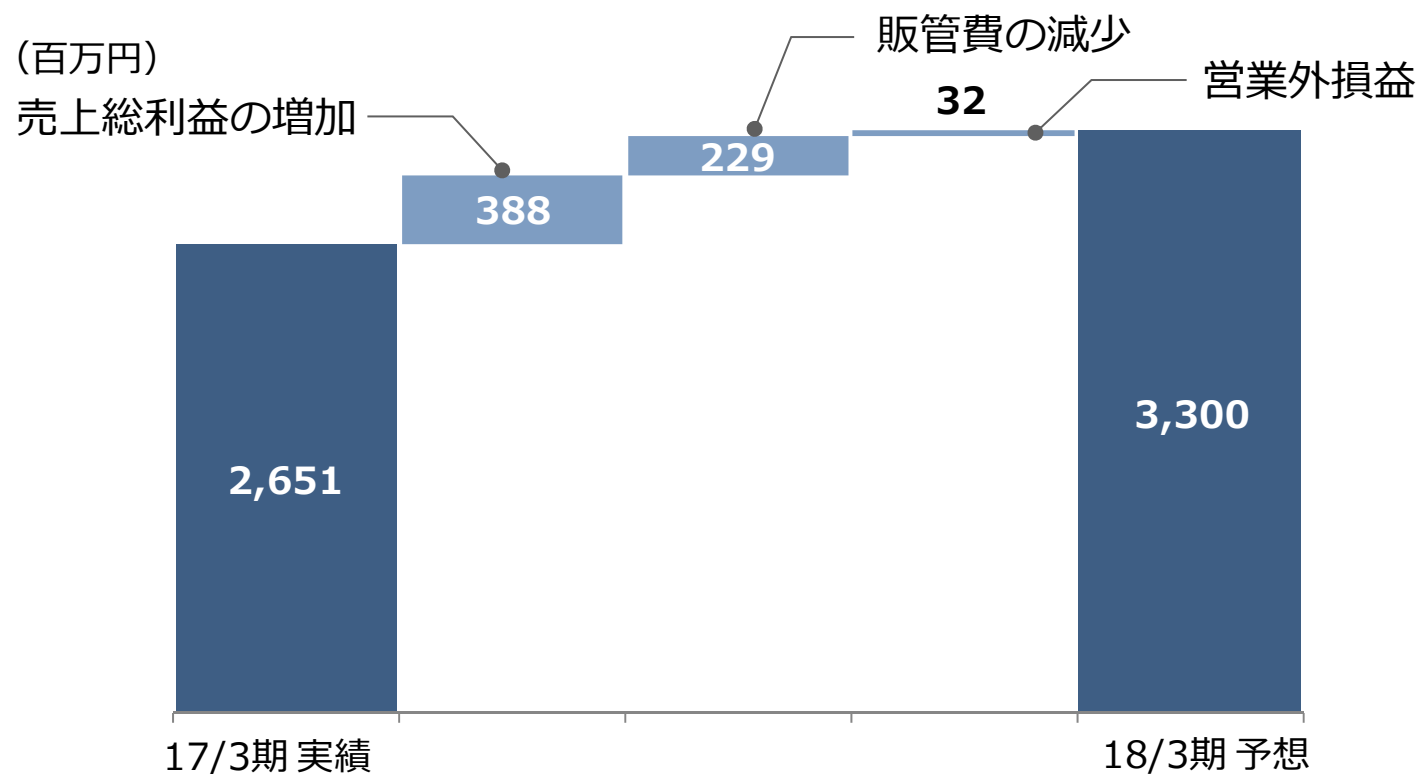
(百万円)



2018年3月期 システム事業品目別売上高予想



経常利益の増減要因（前期 vs. 予想）



売上総利益	利益率の高い商品の売上構成比の増加 17/3月期：206億円(7.6%) → 18/3月期予想：210億円(8.1%)
販管費	退職給付費用の減少 17/3月期：177億円 → 18/3月期予想：175億円
営業外損益	前期並み

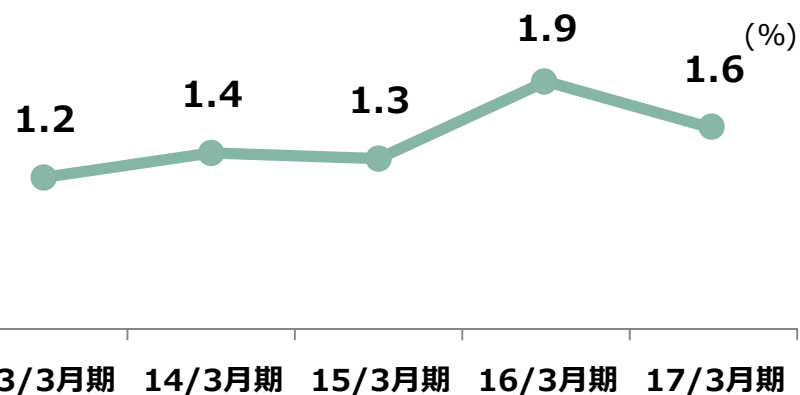
株主還元

株主還元

■ 配当方針

配当性向 連結 30% 以上

■ DOE(株主資本配当率)の推移



■ 配当予想

(円)	17/3月期	18/3月期 (予想)
1株当たり年間配当金	25.00	25.00
中間配当	10.00	10.00
期末配当	15.00	15.00

中期経営計画 事業戦略と重点施策

半導体メーカーの動向

M&Aの大型化

日本企業によるM&A

- QualcommによるNXPの買収
- ソフトバンクによるARMの買収
- ルネサスによるIntersilの買収

国内メーカーの動向

自動車や産業機器関連 **業績堅調**

民生機器や通信機器 **市場縮小**

当社の強み・特長を活かした事業拡大のチャンス

中期経営計画方針

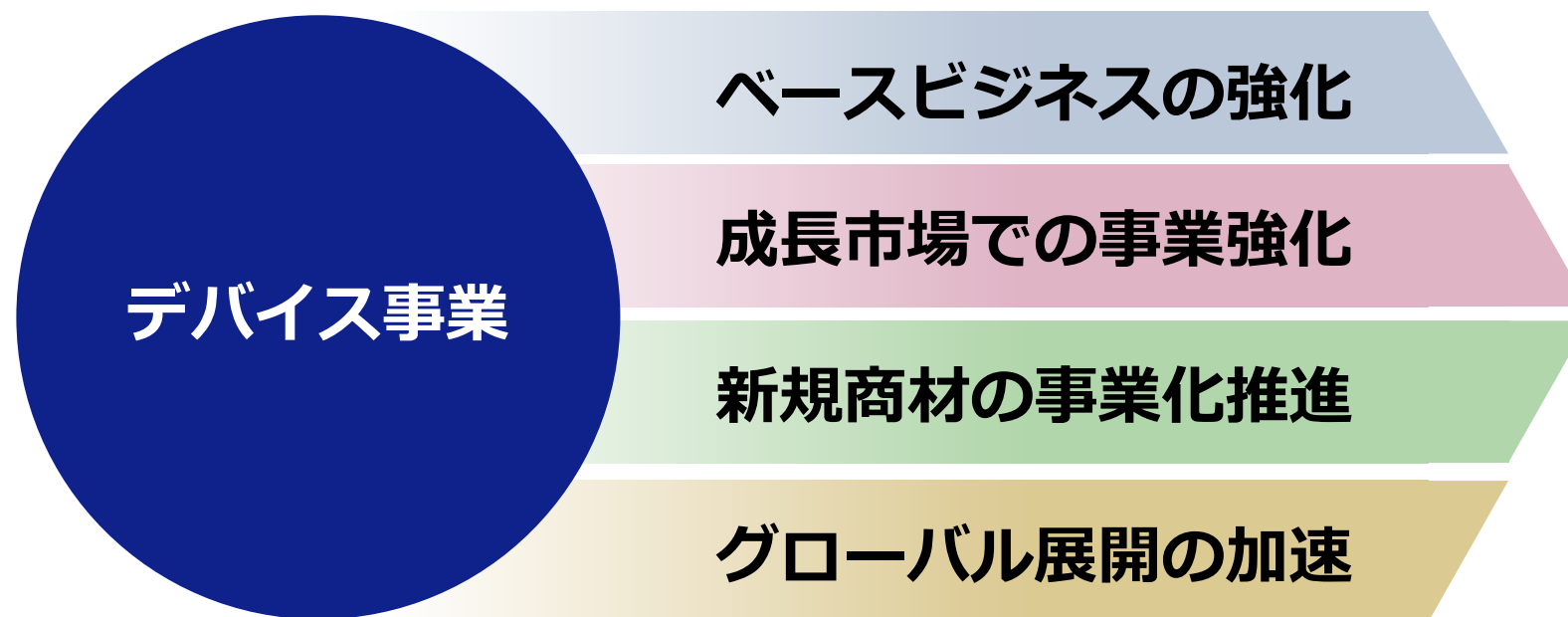
業界再編の
キャッチアップ

積極投資による
新事業の創造

資本効率の向上

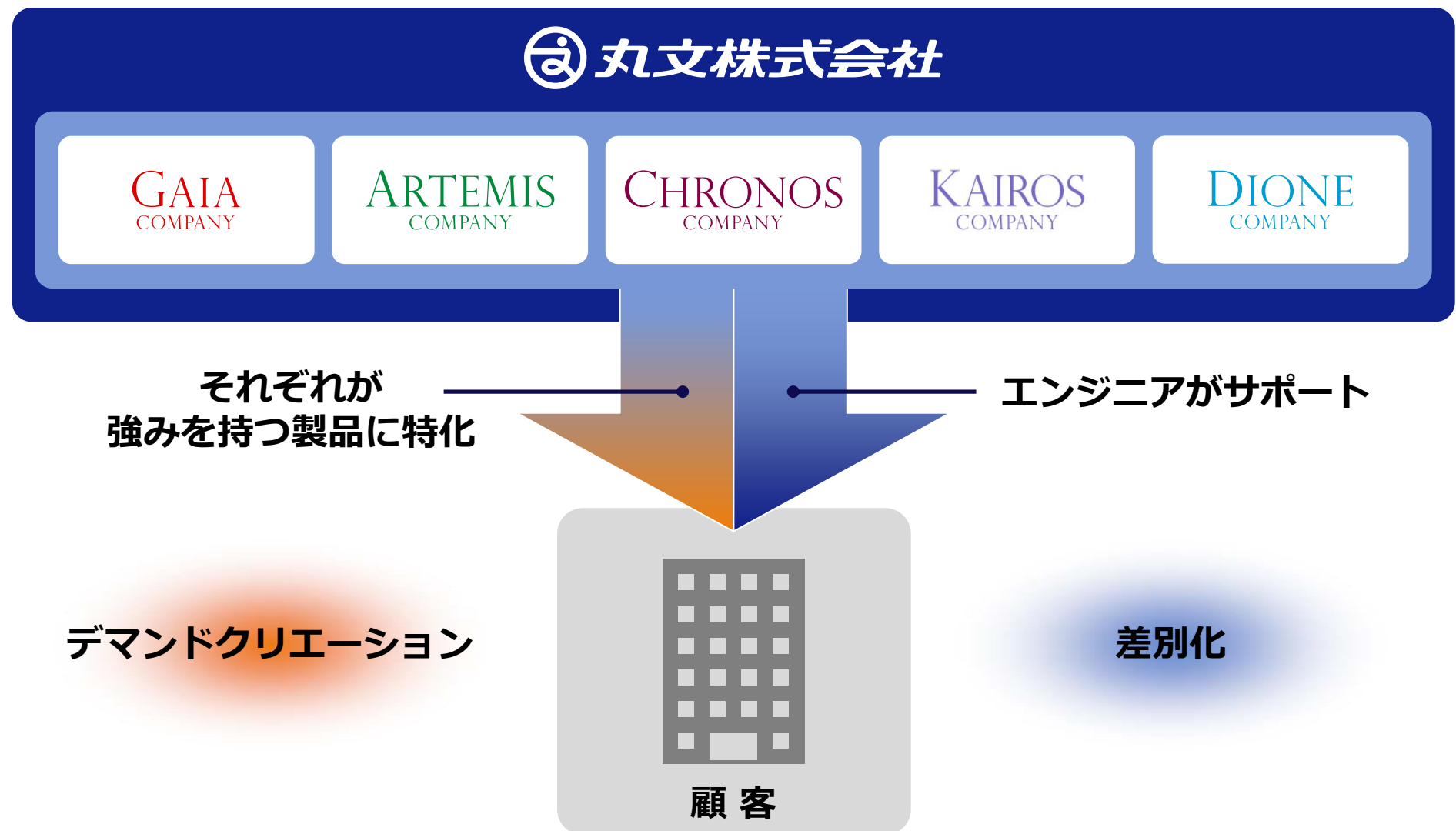
ROE 8%以上

デバイス事業の4つの取り組み



ベースビジネスの強化 ①

■ カンパニー制を導入

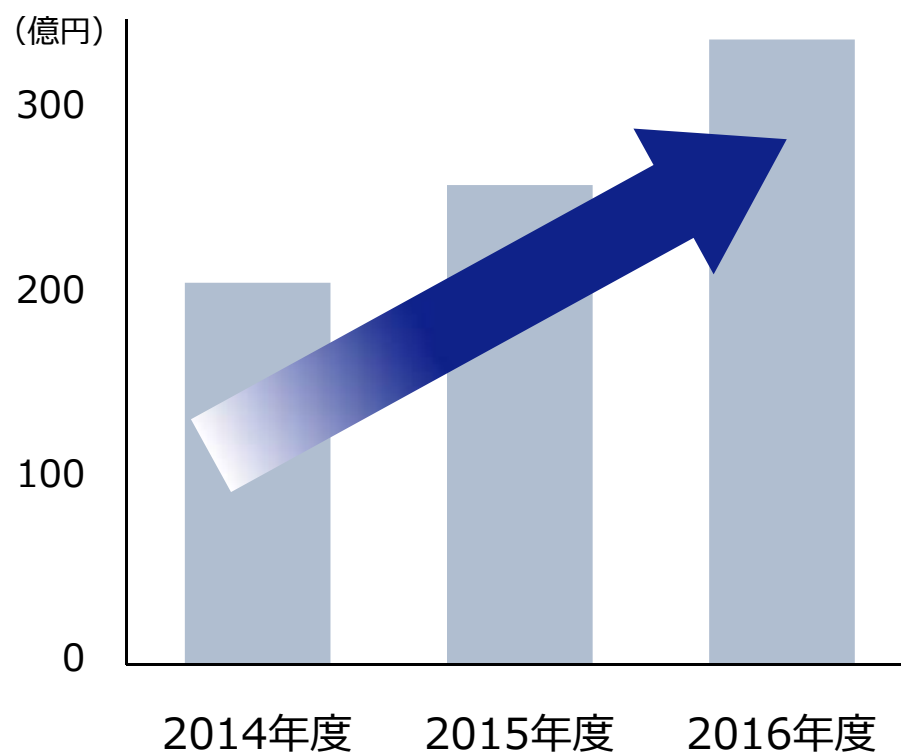


ベースビジネスの強化 ②

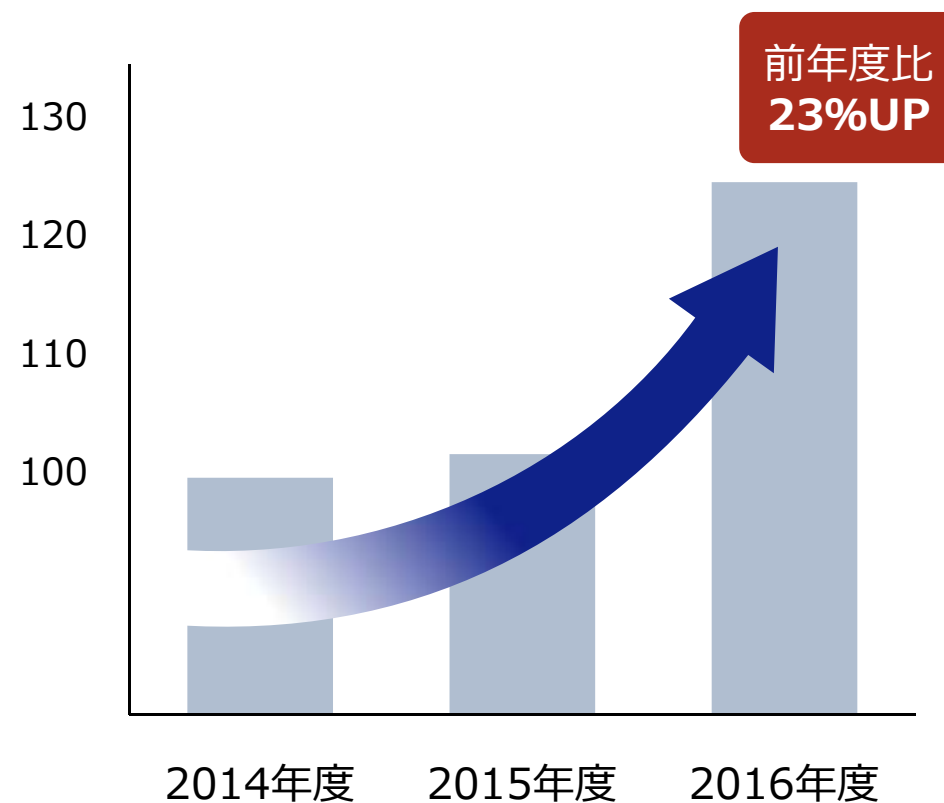
自動車・産業機器市場に注力

- リソースを集中し市場開拓
- KTLを子会社化

自動車市場向け売上高の推移



新規案件発掘数の伸び (2014年度を100とした推移)



成長市場での事業強化

医療分野

- ▶ 新商材の追加
- ▶ 薬機法のライセンスの取得
- ▶ 品質管理部門を新設

MC10社 バイオセンサー



IoT ビジネス

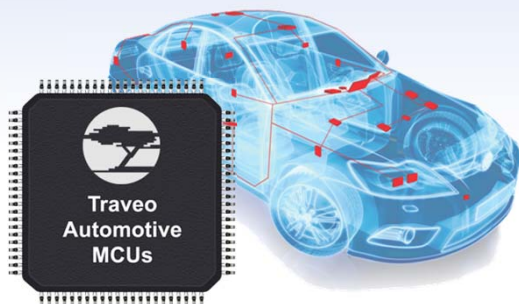


次世代・最先端のテクノロジーに着目

スタートアップ企業の開拓・育成
ラインカードの強化や新たな事業ドメインの開発

Cypress社

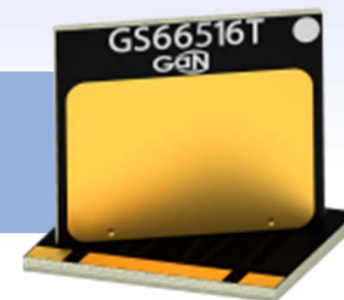
- IoT製品の垂直立ち上げ



GaN Systems社

- パワー半導体のリーディングカンパニー

自動車や発電分野に
販売促進



グローバル展開の加速

欧州

アムステルダムで展開

新オフィス開設を計画

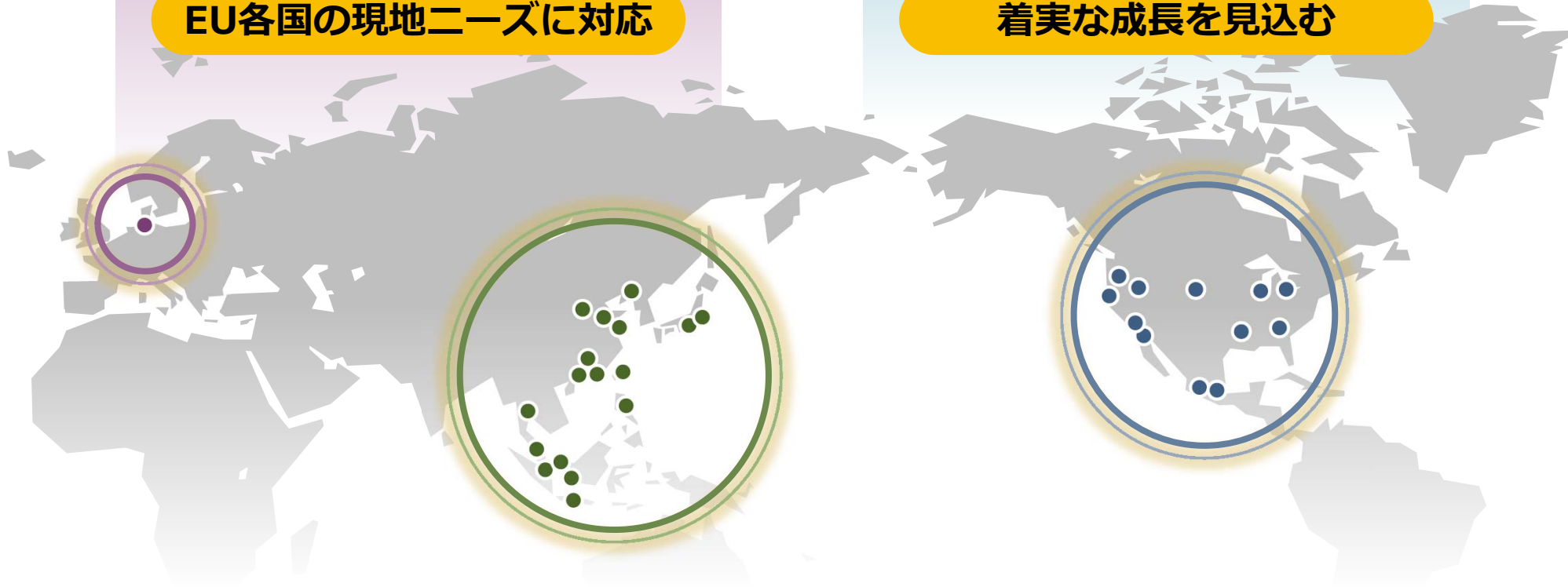
EU各国の現地ニーズに対応

アジア・北米

自動車向けが牽引

顧客の日本本社との関係強化

着実な成長を見込む





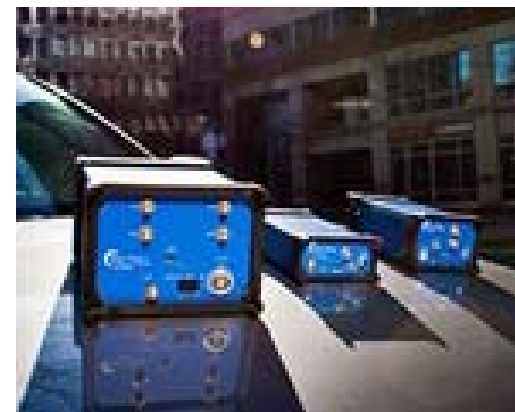
エンジニアリングサービスの拡充
システムインテグレーションの強化

顧客の深耕・拡大
リピート顧客の拡大

システム事業の取組み ①

情報通信

- 独立した部門として運営を開始
- 競争力のある商材を拡充
 - Microsemi社 タイムサーバー
 - Spirent社 GPSシミュレーター
 - PCTEL社 RF信号測定器
- コンサルティング力を高度化



PCTEL社のRF信号測定器

レーザ機器

- 産業機器組込み用半導体レーザ
 - 産業機器・自動車分野での顧客拡大
 - フェムト秒レーザなど取扱製品の拡充
- 医療機器向け光源部品
 - 眼底カメラや血液分析など利用分野を拡大

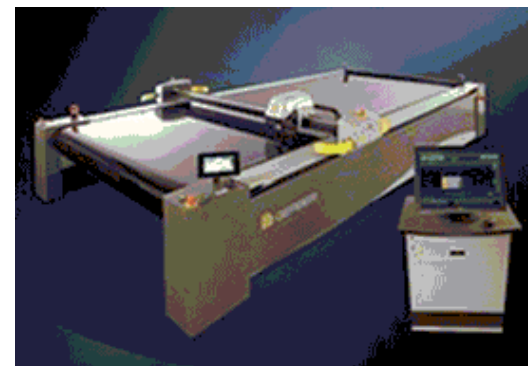


ルミナスデバイス社LED

システム事業の取組み ②

試験計測機器

- 電子部品検査装置
 - 自動車など新たな分野での用途拡大
- Gerber Technology社の裁断機
 - アパレル関連顧客への入れ替え需要の掘り起こし
 - 自動車や産業向け新素材への展開を推進



Gerber Technology社
次世代自動裁断機

医用機器

- 池田医療電機を丸文通商に合併
 - 一体運営による営業力強化
- 取り扱い製品を拡充
- 保守・メンテナンス機能の強化

参考情報

企業概況

会社概要

創 業	1844年（弘化元年）
設 立	1947年（昭和22年）7月
所 在 地	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
資 本 金	62億1,450万円
決算期日	3月31日
代 表 者	代表取締役社長 水野象司
売 上 高	連結 2,706億円（2017年3月期） 単体 1,594億円（2017年3月期）
従業員数	連結 1,397名（2017年3月末） 単体 671名（2017年3月末）
株式上場	東京証券取引所 市場第一部（コード:7537）

事業領域

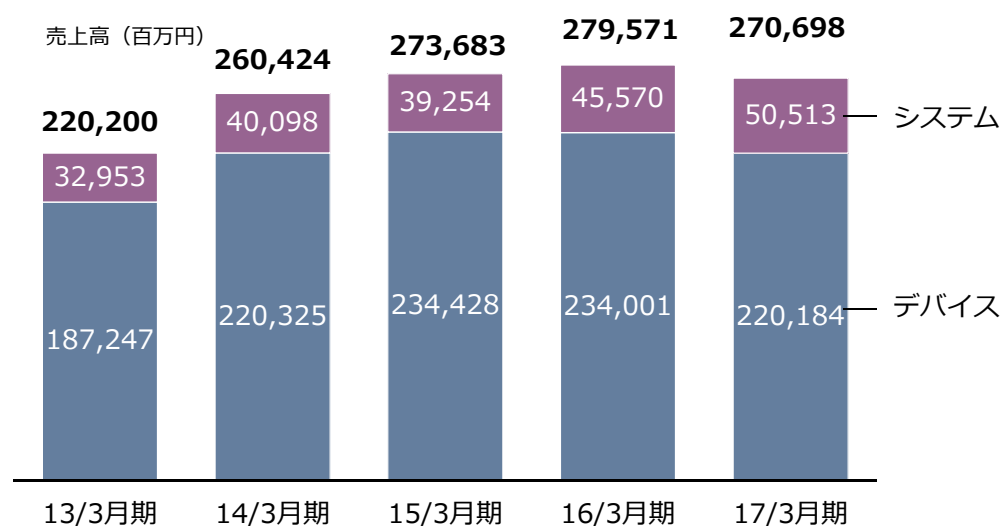
デバイス事業

- 半導体
- 電子部品

システム事業

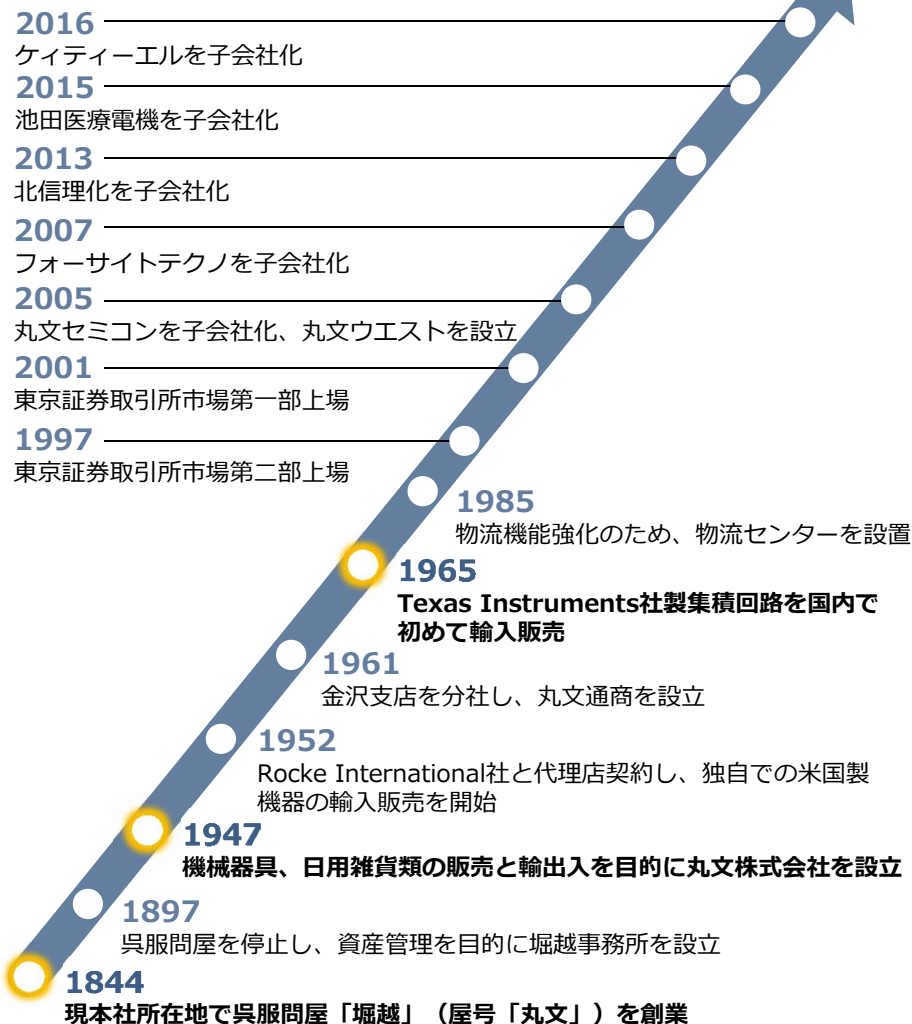
- 航空宇宙機器
- 試験計測機器
- 科学機器
- レーザ機器
- 医用機器

連結売上高の推移

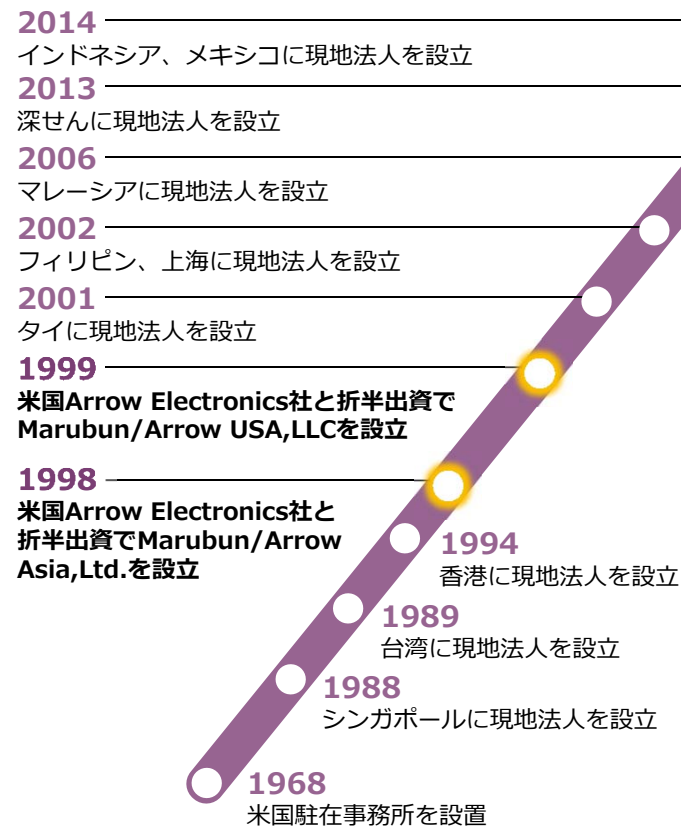


沿革

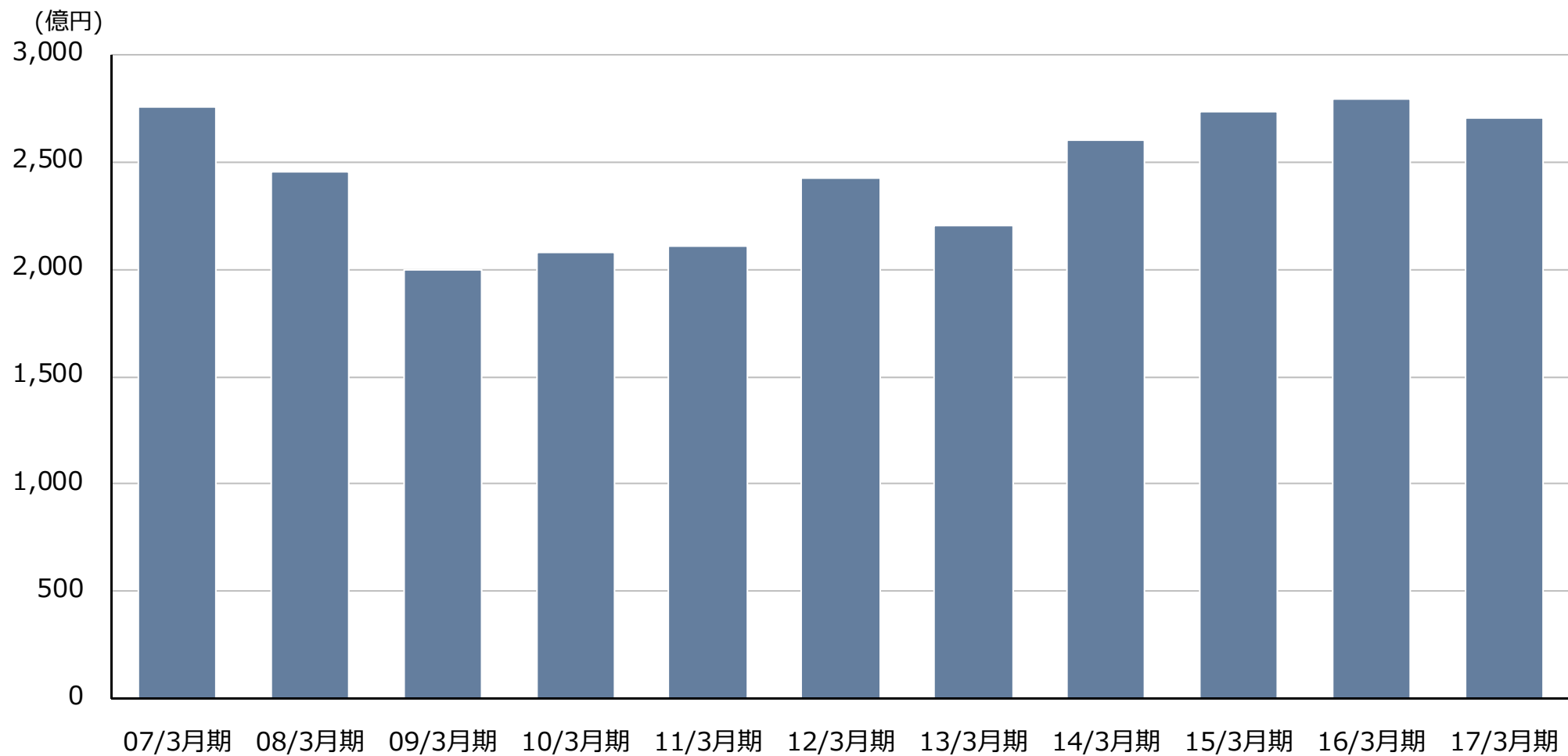
国内



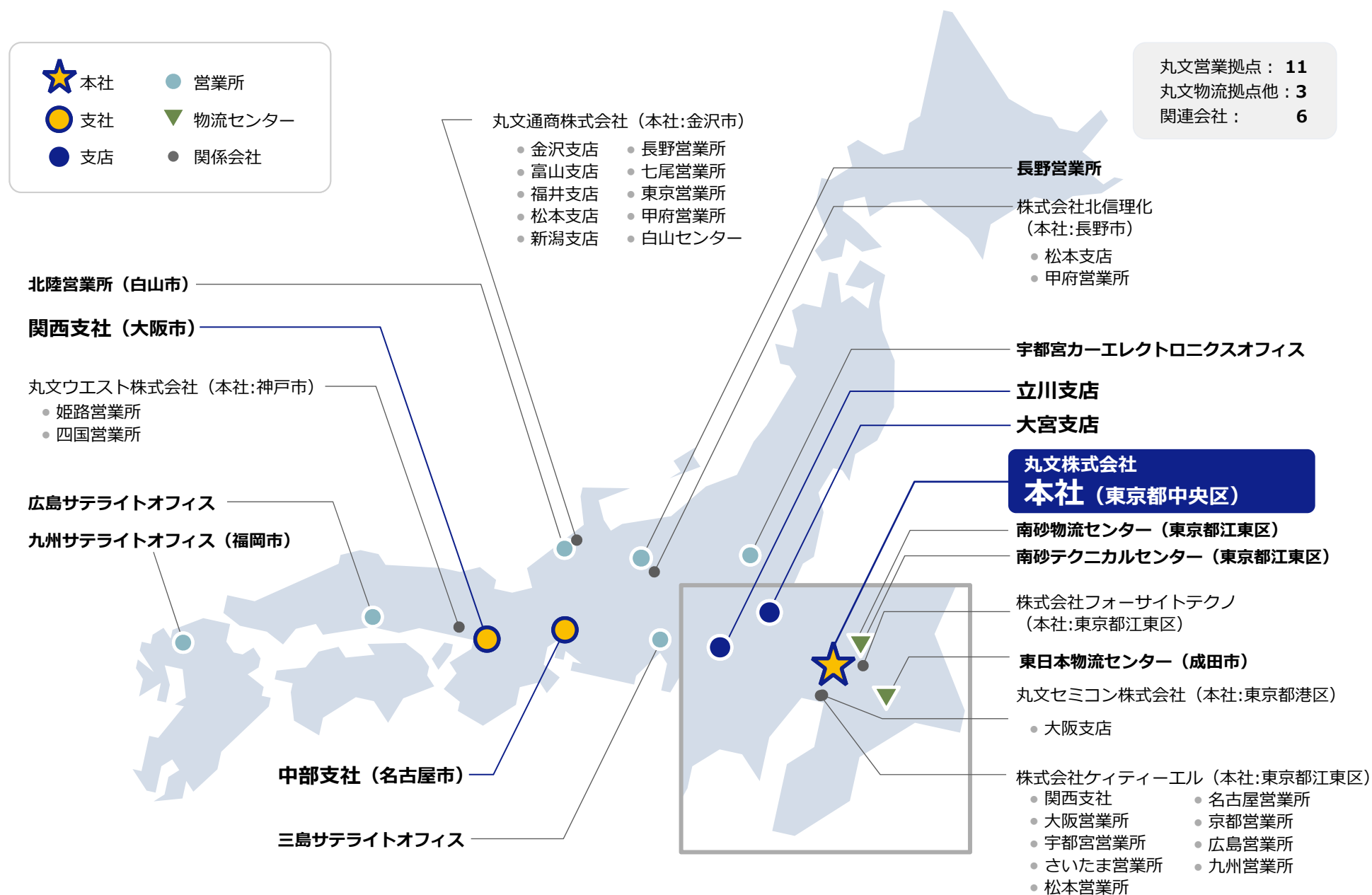
海外



中長期売上トレンド

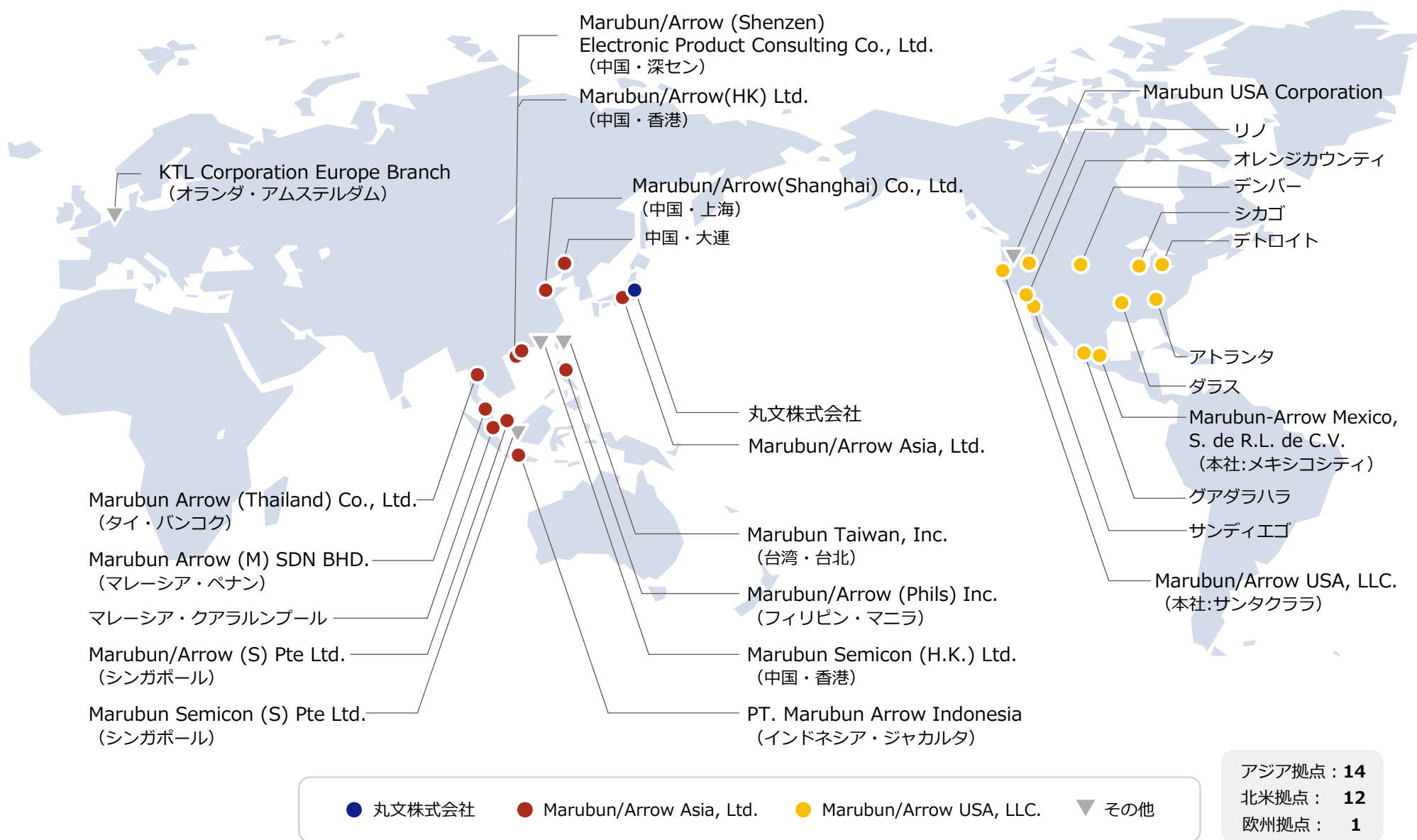


国内拠点



丸文営業拠点： 11
丸文物流拠点他： 3
関連会社： 6

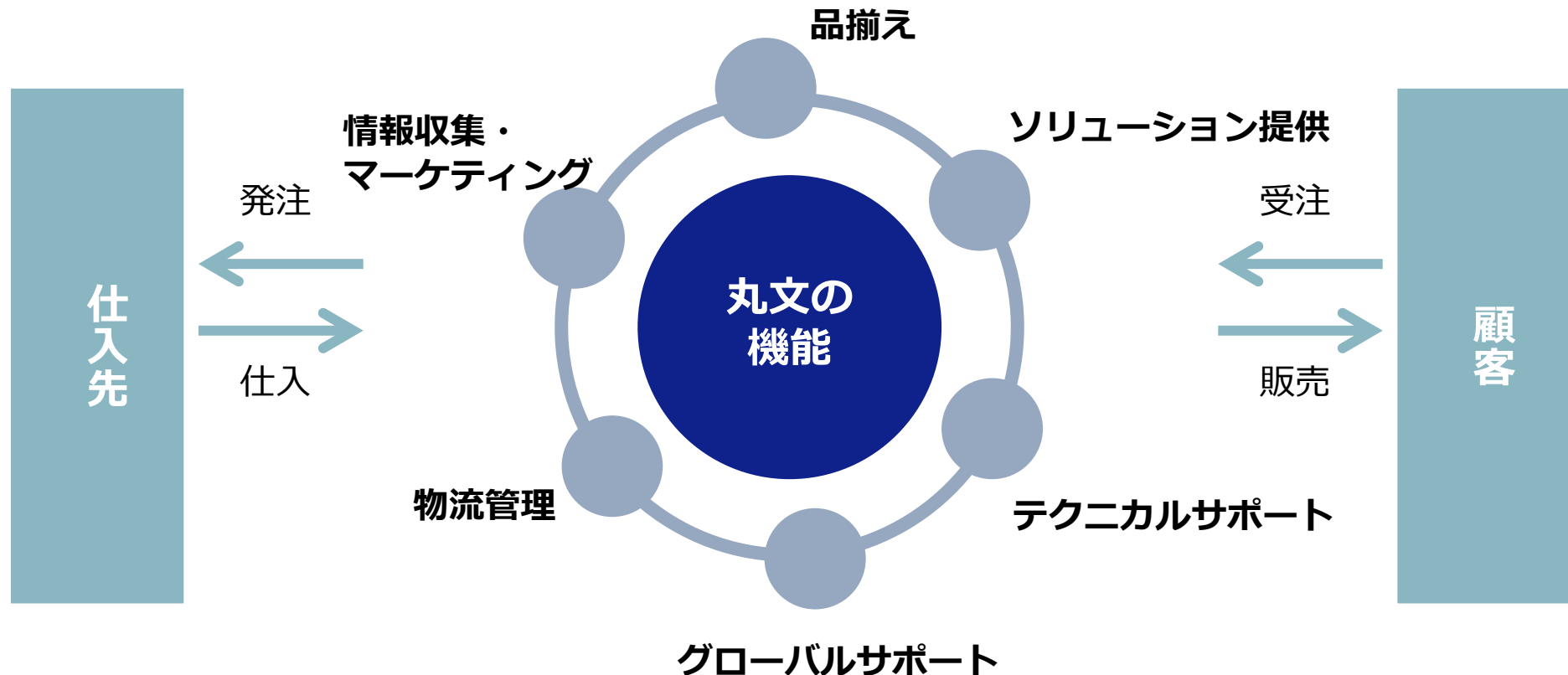
グローバルネットワーク



(2017年5月現在)

デバイス事業：特徴と強み

- 海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え
- 米国アロー社(90ヶ国、465拠点)との提携によるグローバルネットワーク
- 高度な技術力をもとにしたソリューション提案力
- 強固な顧客基盤



デバイス事業：グループ会社概要

社 名	住 所	設立年月	出費比率	事 業 内 容
丸文セミコン株式会社	東京都港区	2005年3月	100.0%	サムスン電子製半導体・電子部品の仕入販売
Marubun Semicon (H.K.) Ltd.	Hong Kong, China	2010年1月	100.0%	
Marubun Semicon (S) Pte. Ltd.	Alexandra Road, Singapore	2013年11月	100.0%	
Marubun USA Corporation	California, U.S.A.	1983年10月	100.0%	丸文アローUSAの持株会社
Marubun Taiwan, Inc.	Taipei, Taiwan	1989年11月	100.0%	台湾製デバイスの仕入販売
Marubun/Arrow Asia, Ltd.	British Virgin Islands	1998年10月	50.0%	丸文アローシンガポール、 丸文アロー香港の持株会社
Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.	Anson Road, Singapore	1988年3月	50.0%	海外進出した日系企業への 半導体・電子部品の仕入販売
Marubun/Arrow (HK) Ltd.	Hong Kong, China	1994年8月	50.0%	
Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd.	Bangkok, Thailand	2000年10月	50.0%	
Marubun/Arrow (Phils), Inc.	Laguna, Philippines	2001年10月	50.0%	
Marubun Arrow (M) SDN BHD	Penang, Malaysia	2006年6月	50.0%	
Marubun/Arrow (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai, China	2002年9月	50.0%	
Marubun/Arrow (Shenzhen) Electronic Product Consulting Co.,Ltd.	Shenzhen, China	2013年6月	50.0%	
PT. Marubun Arrow Indonesia	Jakarta, Indonesia	2014年4月	50.0%	
Marubun/Arrow USA, LLC*	Delaware, U.S.A.	1998年11月	50.0%	
Marubun-Arrow Mexico, S. de R.L. de C.V.*	MexicoCity, MEXICO	2014年9月	50.0%	
株式会社ケイティーエル	東京都江東区	1966年11月	100.0%	半導体・電子部品の仕入販売

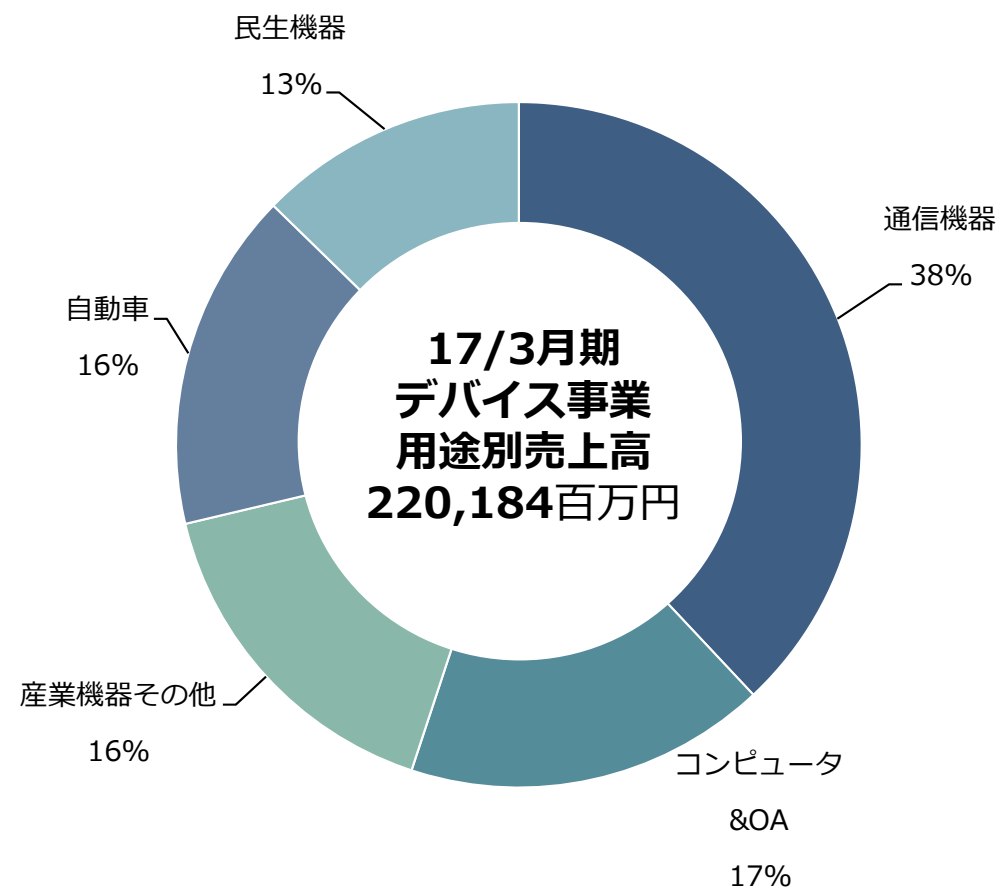
* Marubun/Arrow USA、Marubun-Arrow Mexicoは持分法適用関連会社です。

デバイス事業：取扱製品（サプライヤ別）

			サプライヤ（アルファベット順）														
			旭化成 エレクトロニクス	Broadcom (米国)	Cypress (米国)	Eink (台湾)	FINsix (米国)	IDT (米国)	Maxim (米国)	Molex (米国)	Qorvo (米国)	Samsung (韓国)	SanDisk (米国)	セイコー エプソン	セイコー インスツル	TexasInstruments (米国)	Unimicron (台湾)
半 導 体	アナログIC		●	●					●		●				●	●	
	標準ロジックIC															●	
	メモリーIC	DRAM										●					
		フラッシュ										●	●				
		その他メモリー						●				●	●		●		
	マイクロ プロセッサ	MPU、MCU												●		●	
		DSP	●														●
	特定用途IC	ASSP	●	●	●			●	●		●				●		●
		ディスプレイドライバ											●		●		●
		DMD															●
LED												●					
カスタムIC		●										●		●			
電 子 部 品	表示デバイス					●						●					
	水晶デバイス							●						●	●		
	コネクタ・スイッチ・プリント基板									●							●
	モジュール製品						●										

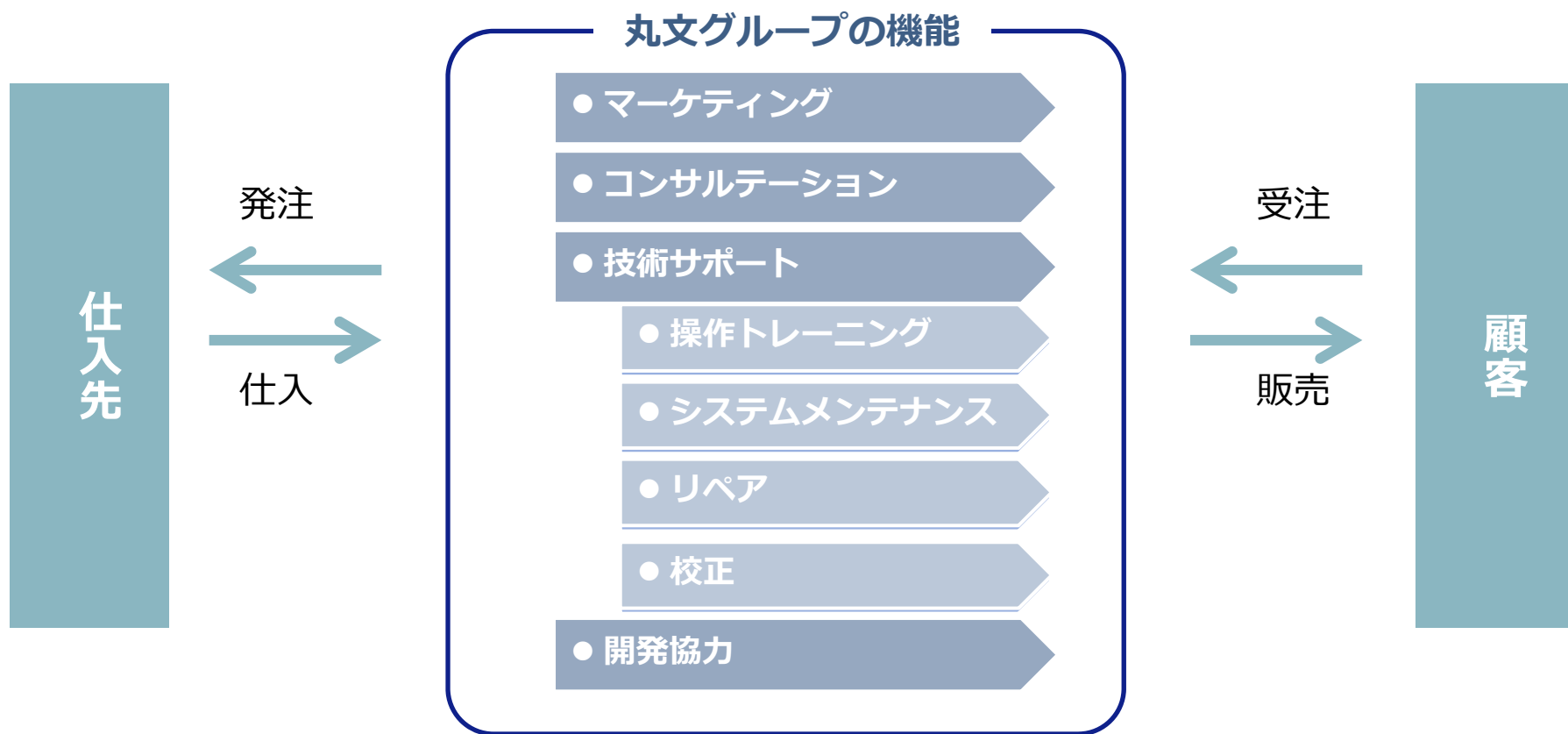
デバイス事業：主要取扱い製品（用途別）

		通信機器	民生機器	コンピュータ & OA	自動車	産業機器
半導体						
アナログIC	アナログ	●	●	●	●	●
	ディスクリート	●	●		●	●
標準ロジックIC		●	●	●	●	●
メモリーIC	DRAM	●	●	●	●	
	フラッシュ	●	●	●		
マイクロ プロセッサ	MPU、MCU	●	●	●	●	●
	DSP	●	●		●	●
特定用途IC	ASSP	●	●		●	
	ディスプレイドライバ	●	●	●	●	
	DMD	●	●	●	●	●
	LED	●	●	●		
カスタムIC		●	●	●	●	
電子部品						
表示デバイス		●	●	●	●	●
水晶デバイス		●	●		●	●
コネクタ・スイッチ・プリント基板		●	●			
モジュール製品			●	●	●	



システム事業：特徴と強み

- ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供
- システム提案から据え付け保守まで、一貫した高レベルの技術サポート

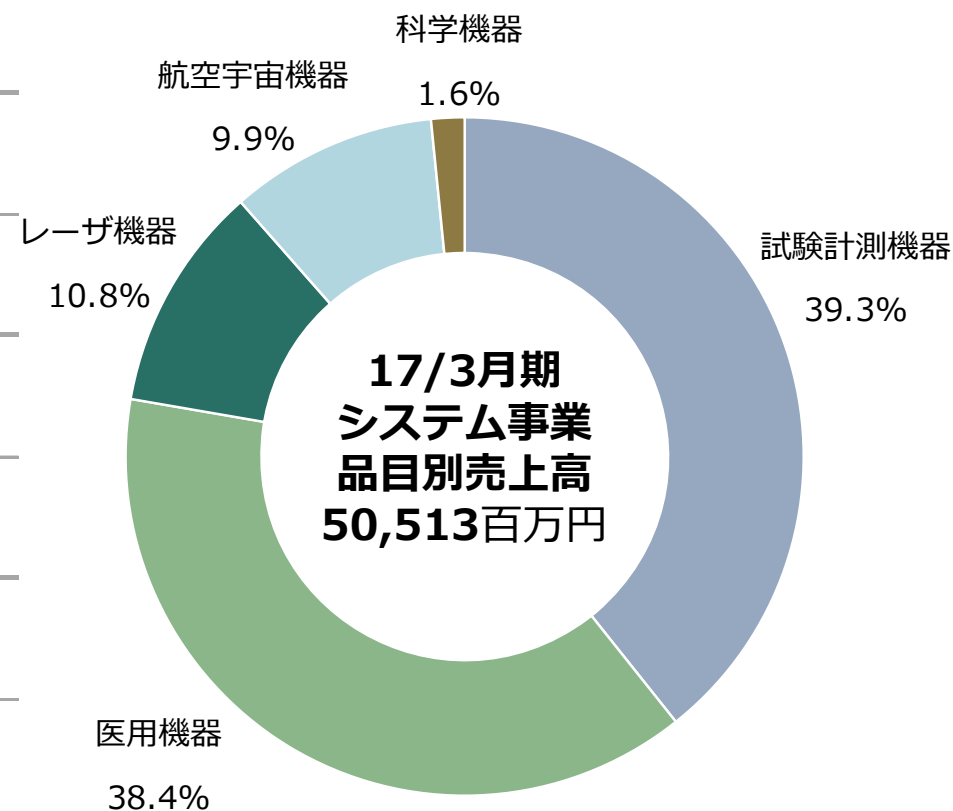


システム事業：グループ会社概要

社 名	本 社	設立年月	出費比率	事 業 内 容
丸文通商株式会社	石川県金沢市	1961年3月	100.0%	医用機器および試験計測機器の仕入販売・修理・メンテナンス
丸文ウエスト株式会社	兵庫県神戸市	2005年5月	100.0%	試験計測機器の仕入販売
株式会社北信理化	長野県長野市	1951年11月	100.0%	試験計測機器の仕入販売
株式会社フォーサイトテクノ	東京都江東区	1999年3月	51.0%	システム製品の修理・メンテナンス、エンジニアリングサービス

システム事業：主要取扱い製品①

分野	主要取扱商品	主要仕入先
医用機器	画像診断機器	シーメンス、島津製作所、 コニカミノルタヘルスケア
	人工透析機器	日機装、旭化成メディカル、 カネカメディックス
試験計測機器	検査・計測機器	アキム、島津製作所、
	組込みコンピュータ	ADLINK、AITECH
	製造装置 組立装置	セイコーエプソン、 日本アビオニクス
航空宇宙機器	高信頼性部品	Tele Communication Systems、
	計測・センサ	Plascore、Lavision
	航空関連機器 高周波電子機器	CPI、L3 Communications
レーザ機器	半導体レーザ	nLight、Laserline
	レーザ加工機	
	ネットワーク機器 光学部品	Microsemi、Calnex Solutions、 Excelitas Technologies
科学機器	MOCVD装置	AIXTRON、Riber
	MBE装置	



システム事業：主要取扱い製品②

航空宇宙機器



BEI Sensors社
人工衛星搭載用部品



CPI社
マイクロ波電子管

科学機器



AIXTRON社 MOCVD装置

試験計測機器



島津製作所社
ガスクロマトグラフ質量分析計



アキム社
電子部品組立装置



DCG社
赤外線発熱解析装置



富士機械製造社
大気圧プラズマ表面改質装置

システム事業：主要取扱い製品③

レーザ機器



Microsemi社
ネットワークタイムサーバー



Laserline社
レーザー加工装置



nLIGHT社
組み込み用半導体レーザー

医用機器



シーメンス・ジャパン社
X線CT装置

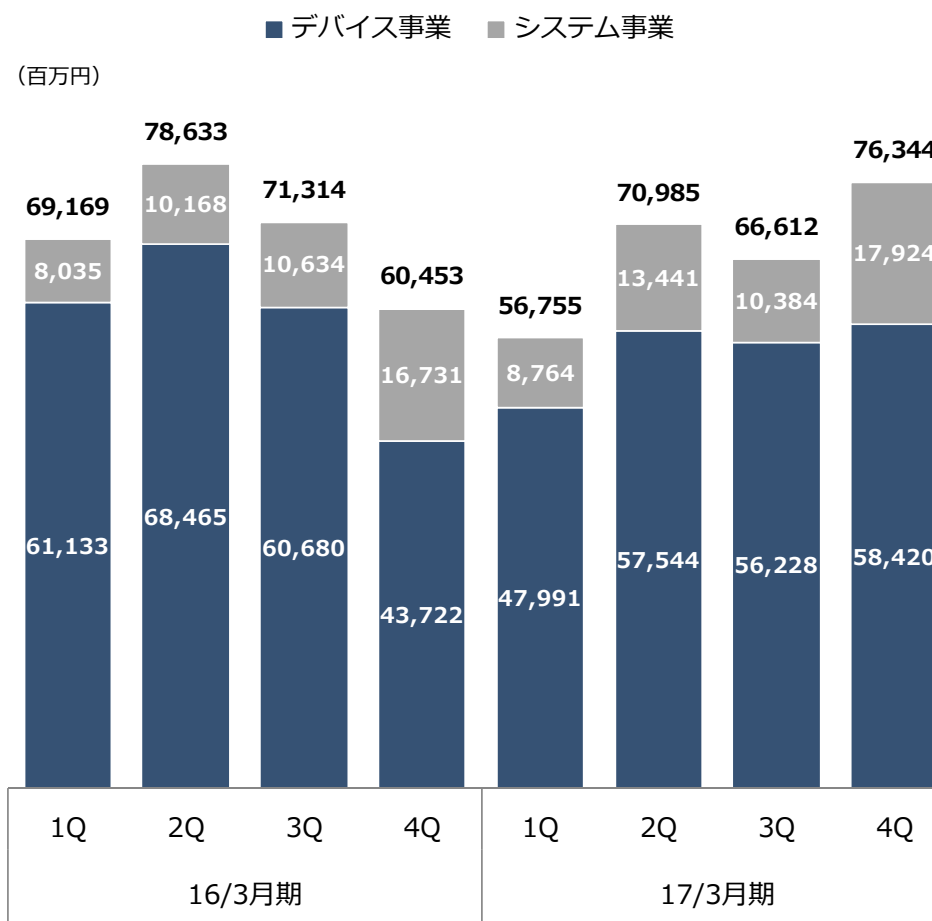
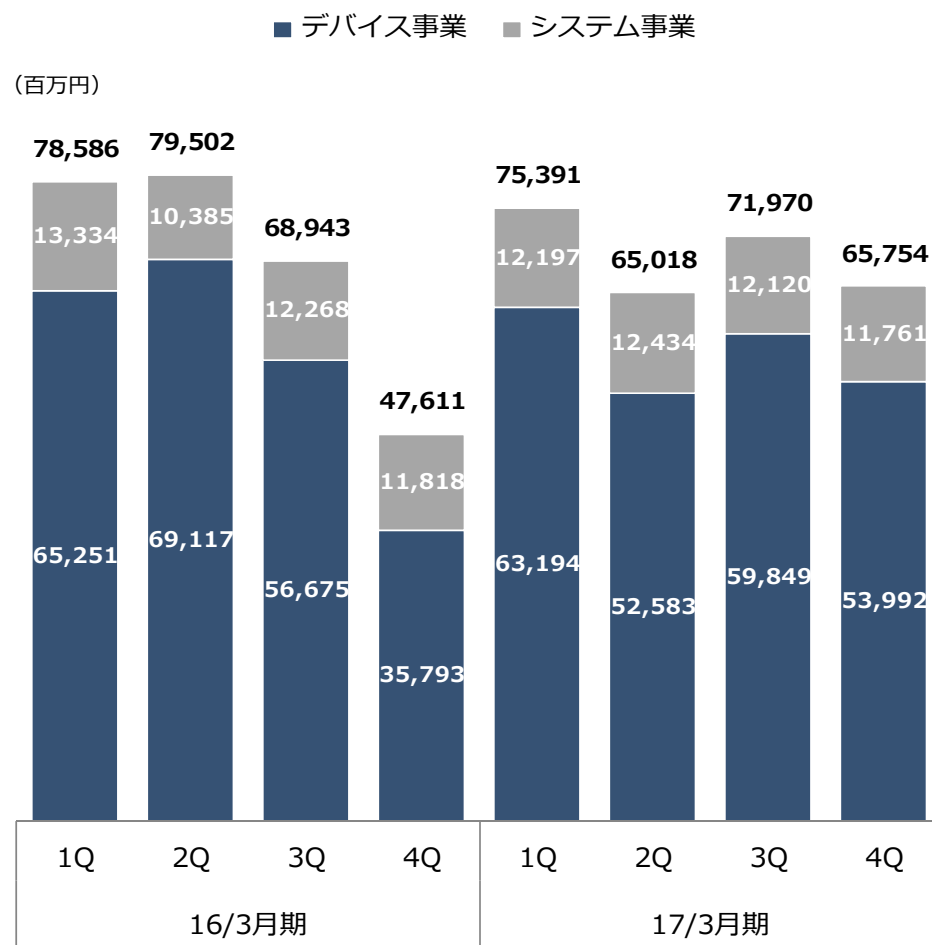


日機装社
人工透析装置

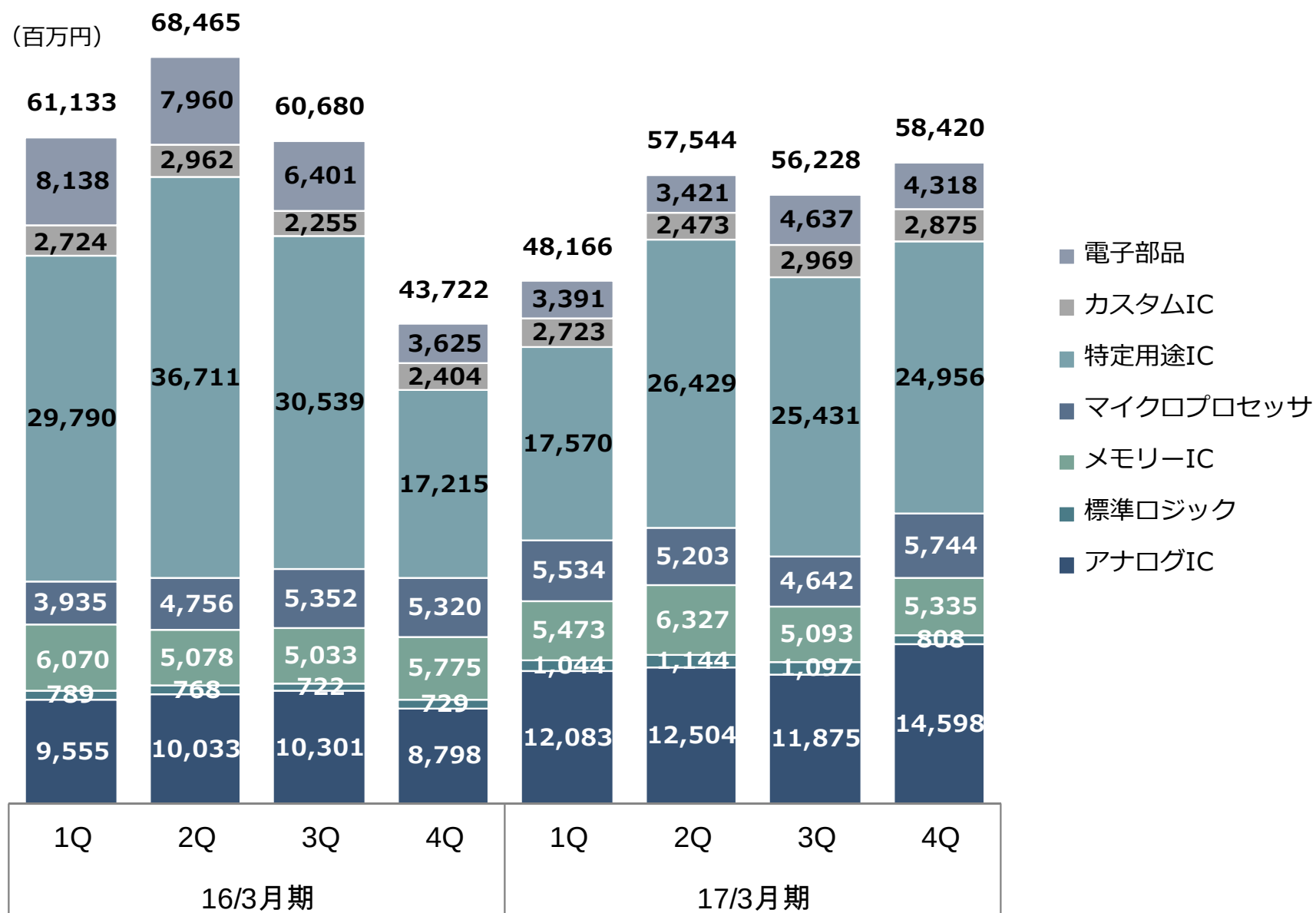
業績四半期推移（事業別受注高・事業別売上高）

事業別受注高

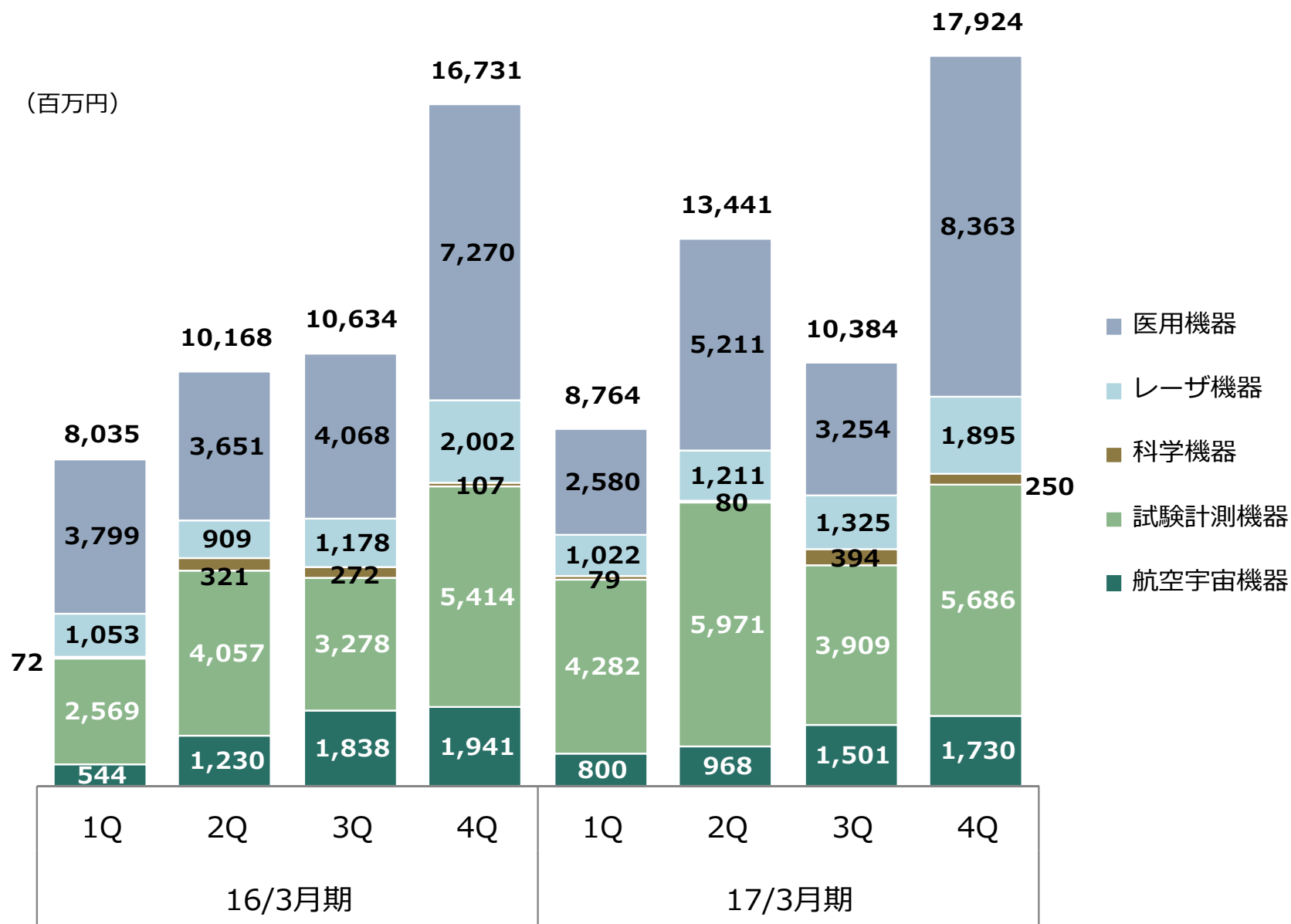
事業別売上高



業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）



業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）



本資料お取り扱い上のご注意

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により異なる可能性がありますことをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ

丸文株式会社 経営企画部

TEL 03-3639-3010

E-mail ir@marubun.co.jp